TP700-H50-9

高导热硅胶垫片

TP700-H50-9是一款高导热性能的材料，双面自粘，与电子组件装配使用时，低压缩力下表现出较低的热阻和较好的电气绝缘特性。在-40°C~150°C可以稳定工作，满足UL94 V-0的阻燃等级要求。

特性和优点

- 导热系数: 7.0W/(m·K)
- 高导热
- 低压缩应力
- 高电气绝缘
- 良好耐温性能
- 韧性好易操作

典型应用

- 电压调节模块（VRMs）
- ASICs和DSPs
- 高导热需求模块
- 高热量BGAs
- CD ROM/DVD ROM
- 网络通信设备

典型属性		
属性	**典型值**	**测试方法**
颜色	淡蓝色	目视
厚度(mm)	0.5~10.0	ASTM D374
密度(g/cc)	3.3	ASTM D792
硬度(Shore 00)	50	ASTM D2240
重量损失(%,挥发、渗出)	≤1.0	滤纸吸附@压缩25%/125°C/48h
耐温范围(°C)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	12	温度＜40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	＞6.0	ASTM D149
介电常数(@1MHz)	7.1	ASTM D150
体积电阻率(Ω·cm)	10^{12}	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	7.0	ISO 22007-2
热阻(°C·in^2/W @20psi,1.0mm)	0.13	ASTM D5470

在本文档中提供的任何信息都被认为是准确的。所有规格如有更改，恕不另行通知。所有产品和服务均按销售条款和条件出售。卖方或制造商均不对侵权行为或合同中的任何直接，偶然或后果性损失或损害承担责任，包括因使用或无法使用产品而造成的利润或收入损失，除非卖方和制造商的官员签署协议，否则此处未包含的卖方或购买方的任何声明，采购订单或建议均不具有任何效力。
©版权所有2019，AOCHUAN TECHNOLOGY。

AOK 傲川科技 AOCHUAN TECHNOLOGY